

平成20年9月期 決算説明会



Automobile Industry



Electronics Industry

Nov 12, 2008

1/32



平成20年9月期
業績結果について



2/32

<連結>



平成20年9月期決算概要-①

連結損益計算書

(単位 百万円)

	20/9期	19/9期	増減額	増減率
売上高	46,225	45,219	+1,005	+2.2%
売上総利益	13,083	12,755	+327	+2.6%
売上総利益率	28.3%	28.2%		+0.1P
販管費	7,370	7,211	+159	+2.2%
販管費率	15.9%	15.9%		-
営業利益	5,712	5,544	+167	+3.0%
営業利益率	12.4%	12.3%		+0.1P
経常利益	5,851	5,853	△1	△0.0%
経常利益率	12.7%	12.9%		△0.2P
当期純利益	3,109	3,553	△444	△12.5%
当期純利益率	6.7%	7.9%		△1.1P

■ 売上高の増加

平面研磨事業
半導体・HDD業界向けの設備・消耗品販売が牽引

抵抗溶接事業

日本・中国・韓国などで増収となったものの、米国での設備品・消耗品販売がいずれも低調に推移したことなどにより微減

■ 営業利益の増加

平面研磨事業
高付加価値品の装置販売が牽引し、概ね期初計画水準を達成

抵抗溶接事業

低利益販売品の改善を図るとともに、継続的な原価低減活動などにより、収益は改善。しかしながら夏以降の経済環境激変に伴う売上減少により当初利益計画は未達

3/32



<連結>



平成20年9月期決算概要-②

連結損益計算書

■ セグメント別損益

(単位 百万円)

	抵抗溶接	増減額	レーザー	増減額	平面研磨	増減額	合計	増減額
売上高	19,695	△195	381	+24	26,148	+1,176	46,225	+1,005
売上総利益	5,262	+285	70	△3	7,750	+46	13,083	+327
売上総利益率	26.7%	+1.7P	18.4%	△2.3P	29.6%	△1.2P	28.3%	+0.1P
販管費	3,767	+126	119	△22	3,483	+55	7,370	+159
販管費率	19.1%	+0.8P	31.3%	△8.4P	13.3%	△0.4P	15.9%	-
営業利益	1,494	+159	△49	+18	4,266	△8	5,712	+167
営業利益率	7.6%	+0.9P	△12.9%	+6.0P	16.3%	△0.8P	12.4%	+0.1P

* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

4/32



<連結>



平成20年9月期決算概要-③

連結損益計算書

■ 販売費及び一般管理費

(単位 百万円)

	20/9期		19/9期		増減
	金額	売上比	金額	売上比	金額
人件費	3,587	7.8%	3,600	8.0%	△12
減価償却費	351	0.7%	439	1.0%	△87
運送費	722	1.6%	700	1.5%	+21
旅費交通費	512	1.1%	511	1.1%	+1
研究開発費	523	1.1%	277	0.6%	+246
その他	1,672	3.6%	1,681	3.7%	△8
合計	7,370	15.9%	7,211	15.9%	+159
期末従業員数	1,631人		1,572人		59人増



5/32

<連結>



平成20年9月期決算概要-④

営業外損益

再投資税額還付金(+) → 182百万円
為替差損(△) → 166百万円

法人税等

税効果適用後の実効税率 → 45.4% (19/9期 35.4%)



6/32

<連結>



平成20年9月期決算概要-⑤

連結貸借対照表

(単位 百万円)

資産	20/9期		19/9期		増減	負債純資産	20/9期		19/9期		増減
	金額	構成比	金額	構成比			金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	24,955	68.6%	33,347	72.9%	△8,392	流動負債	10,556	29.0%	20,407	44.7%	△9,851
有形固定資産	9,382	25.8%	9,465	20.7%	△83	固定負債	637	1.8%	970	2.1%	△333
無形固定資産	225	0.6%	256	0.6%	△31	(有利子負債)	(1,921)	(5.3%)	(6,728)	(14.7%)	(△4,807)
投資等	1,791	5.0%	2,646	5.8%	△854	純資産	25,161	69.2%	24,337	53.2%	+823
合計	36,355	100.0%	45,716	100.0%	△9,360	合計	36,355	100.0%	45,716	100.0%	△9,360

<主な増減>

売掛債権	→	4,594百万円減	(20/9期	10,383百万円	19/9期	14,977百万円)
たな卸資産	→	1,623百万円減	(20/9期	7,445百万円	19/9期	9,069百万円)
その他流動資産	→	1,725百万円減	(20/9期	1,336百万円	19/9期	3,061百万円)
買掛債務	→	3,108百万円減	(20/9期	4,701百万円	19/9期	7,810百万円)
自己資本比率	→	20/9期 67.3%	19/9期	51.1%		



7/32



通期の見通しと グループの展望



8/32

<連結>

連結会社の系統図



OBARA株式会社



溶接

平面研磨装置

OBARA CORP. USA
 小原（南京）機電有限公司
 小原（上海）有限公司
 韓国小原株式会社
 OBARA (THAILAND) CO., LTD.
 OBARA (MALAYSIA) SDN. BHD.
 洋光産業株式会社
 OBARA MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.
 OBARA AUSTRALIA PTY. LTD.
 OBARA INDIA PRIVATE LTD.
 LLC "OBARA RUS"

スピードファム株式会社

スピードファム長野株式会社
 SPEEDFAM INC. (台湾)
 SPEEDFAM (INDIA) PVT LTD.
 SPEEDFAM MECHTRONICS (上海)
 SPEEDFAM CORPORATION (USA)
 S/Fクリーンシステム株式会社
 SpeedFam NV/SA (ベルギー)
 SPEEDFAM KOREA LTD.



9/32

<連結>



平成21年9月期業績予想(通期連結)

(単位 百万円)

	21/9期予想	20/9期実績	増減額	増減率
売上高	30,000	46,225	△16,225	△35.1%
売上総利益	7,250	13,083	△5,833	△44.6%
売上総利益率	24.2%	28.3%		△4.1P
販管費	6,700	7,370	△670	△9.1%
販管費率	22.3%	15.9%		+6.4P
営業利益	550	5,712	△5,162	△90.4%
営業利益率	1.8%	12.4%		△10.6P
経常利益	700	5,851	△5,151	△88.0%
経常利益率	2.3%	12.7%		△10.4P
当期純利益	80	3,109	△3,029	△97.4%
当期純利益率	0.3%	6.7%		△6.4P



10/32

<連結>



平成21年9月期予想(上・下半期)

(単位 百万円)

	21/9期 上半期予想	前 同 期 比	21/9期 下半期予想	前 同 期 比
売 上 高	16,000	△8,213	14,000	△8,012
売 上 総 利 益	3,900	△3,030	3,350	△2,802
売 上 総 利 益 率	24.4%	△4.2P	23.9%	△4.0P
販 管 費	3,400	△120	3,300	△550
販 管 費 率	21.3%	+6.7P	23.6%	+6.1P
営 業 利 益	500	△2,909	50	△2,252
営 業 利 益 率	3.1%	△11.0P	0.4%	△10.1P
経 常 利 益	570	△2,973	130	△2,178
経 常 利 益 率	3.6%	△11.1P	0.9%	△9.6P
当 期 純 利 益	200	△1,831	△120	△1,197
当 期 純 利 益 率	1.3%	△7.1P	△0.9%	△5.8P



11/32

<連結>



平成21年9月期業績予想(セグメント別)

(単位 百万円)

	溶接	前 同 期 比	平面研磨	前 同 期 比	合 計	前 同 期 比
売 上 高	18,000	△2,076	12,000	△14,148	30,000	△16,225
売 上 総 利 益	4,500	△832	2,750	△5,000	7,250	△5,833
売 上 総 利 益 率	25.0%	△1.6P	22.9%	△6.7P	24.2%	△4.1P
販 管 費	3,600	△287	3,100	△383	6,700	△670
販 管 費 率	20.0%	+0.6P	25.8%	+12.5P	22.3%	+6.4P
営 業 利 益	900	△545	△350	△4,616	550	△5,162
営 業 利 益 率	5.0%	△2.2P	△2.9%	△19.2P	1.8%	△10.6P



* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

* 溶接にはレーザが含まれております。

12/32

<連結>



主な項目の実績と予想

(平成20年9月期実績) (平成21年9月期予想)

- ◆ 設備投資
1,751百万円 → 1,000百万円
- ◆ 減価償却費
1,154百万円 → 1,000百万円
- ◆ 研究開発費
742百万円 → 700百万円
- ◆ 銅価格
89万円/ton → 50万円/ton
- ◆ 為替想定レート

\$=100円(1円の変動で約15百万円の経常利益が変動)

注) 設備投資は有形無形を含む



13/32

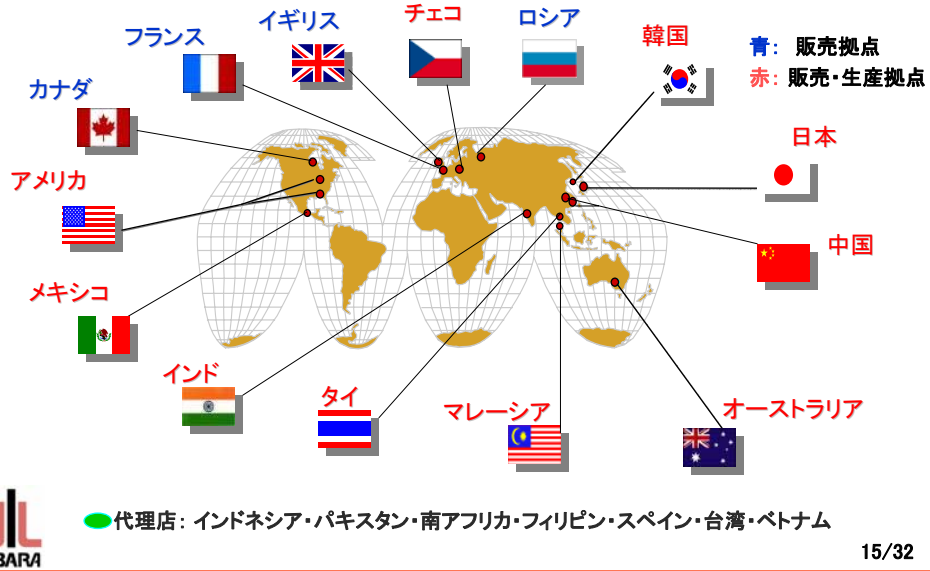
<溶接連結>



14/32

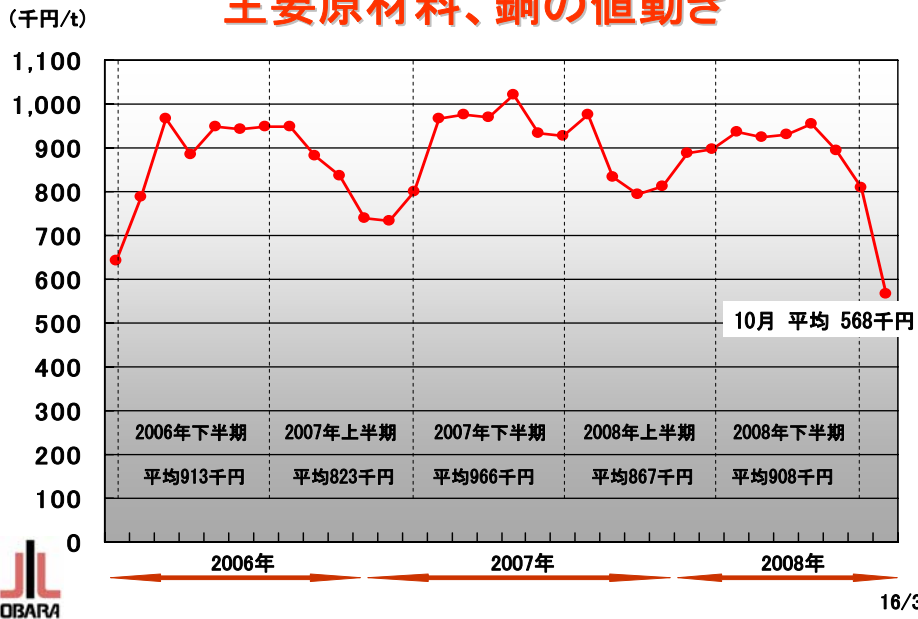
<溶接連結>

グローバルネットワーク



<溶接連結>

主要原材料、銅の値動き



<溶接連結>

溶接事業 平成21年9月期業績予想

(単位 百万円)

	21/9期 上半期予想	前同期比	21/9期 下半期予想	前同期比	21/9期 通期予想	前同期比
売上高	9,000	△1,955	9,000	△121	18,000	△2,076
売上総利益	2,260	△720	2,240	△112	4,500	△832
売上総利益率	25.1%	△2.1P	24.9%	△0.9P	25.0%	△1.6P
販管費	1,750	△102	1,850	△184	3,600	△287
販管費率	19.4%	+2.5P	20.6%	△1.7P	20.0%	+0.6P
営業利益	510	△617	390	+71	900	△545
営業利益率	5.7%	△4.6P	4.3%	+0.8P	5.0%	△2.2P

* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

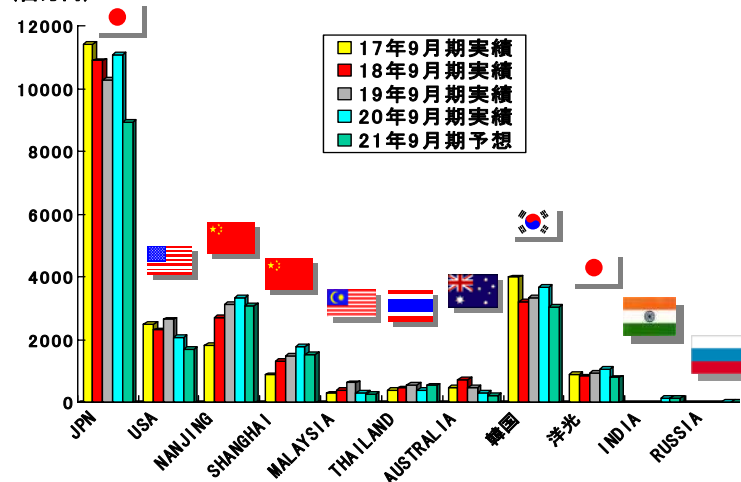


17/32

<溶接連結>

会社別の売上高予想と実績

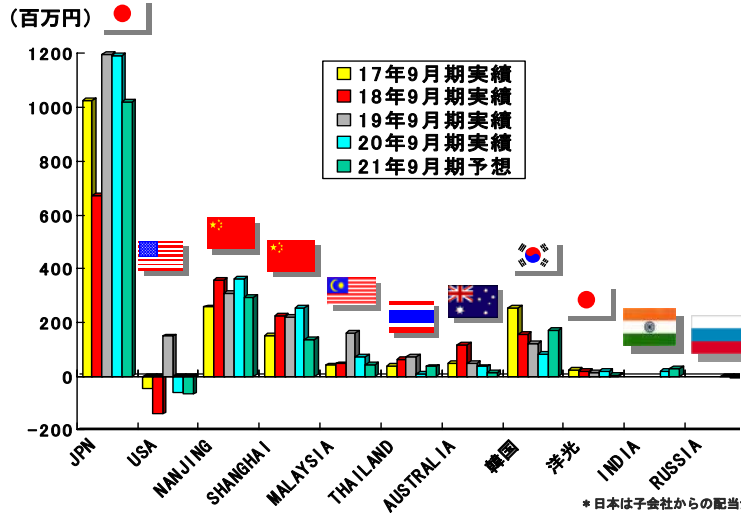
(百万円)



18/32

<溶接連結>

会社別の当期純利益実績と予想



<溶接連結>

Topics

アジア地域への展開強化



平面研磨事業の概況



21/32

平面研磨事業の概況

主要エレクトロニクス分野が調整局面に

- 消耗副資材の拡販を積極化
- シリコンウェーハ及びハードディスク業界における、設備増強ニーズの復調タイミングを注視
- 一層の製品差別化へ、R&D活動の強化

22/32

商品群

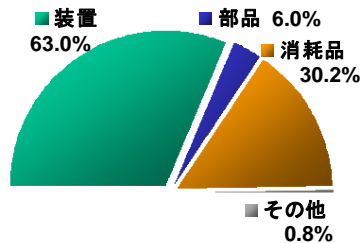
- ▶ 片面研磨装置、両面研磨装置
- ▶ 端面研磨装置（エッジポリッシャー）
- ▶ 洗浄装置
- ▶ ドライエッチャー装置（DCP）
- ▶ 消耗副資材（定盤・研磨剤・研磨布など）

平面研磨事業

23/32

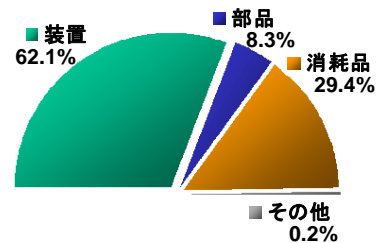
セグメント情報 — 商品別売上構成比 —

19年9月期



(24,972百万円)

20年9月期



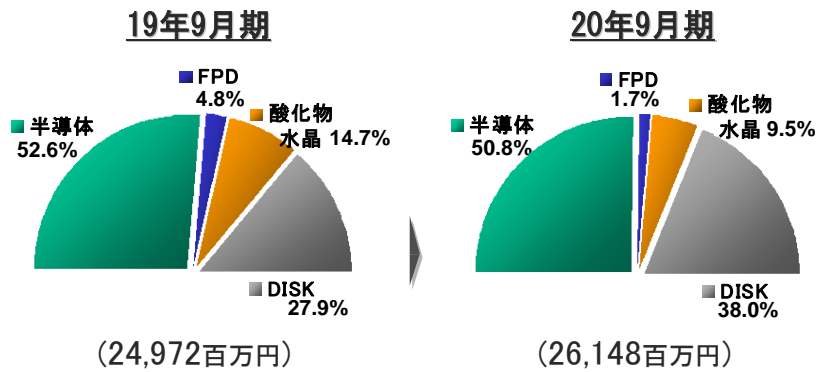
(26,148百万円)

平面研磨事業

24/32

セグメント情報

— アプリケーション別売上構成比 —



傾注項目の結果と展開

- ▶ 最先端 Si ウェーハ向け両面研磨装置

売上計上54億円と受注残高1億円
- ▶ ハードディスク向け装置

売上計上57億円と受注残高11億円
- ▶ 先端要求への技術革新に注力

21年9月期 研究開発関連：通期4.5億円

前期実績対比で15%増を計画

平面研磨事業 21年9月期業績予想

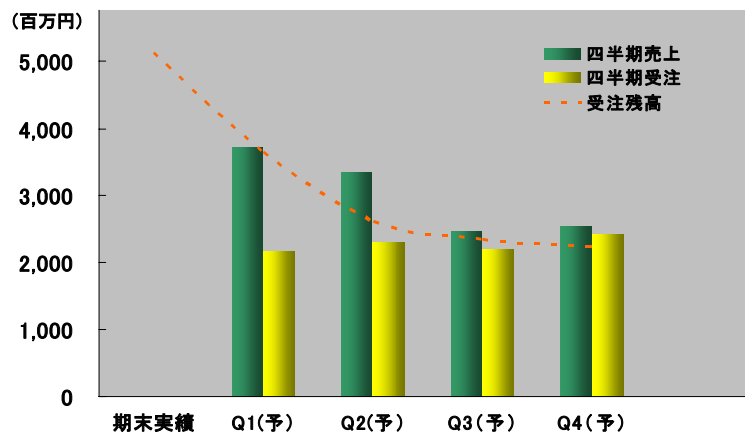
(単位 百万円)

	21/9期 上半期予想	前同期比	21/9期 下半期予想	前同期比	21/9期 通期予想	前同期比
売上高	7,000	△6,257	5,000	△7,891	12,000	△14,148
売上総利益	1,650	△2,299	1,100	△2,700	2,750	△5,000
売上総利益率	23.6%	△6.2P	22.0%	△7.5P	22.9%	△6.7P
販管費	1,560	△107	1,540	△276	3,100	△383
販管費率	22.3%	+9.7P	30.8%	+16.7P	25.8%	+12.5P
営業利益	90	△2,191	△440	△2,424	△350	△4,616
営業利益率	1.3%	△15.9P	△8.8%	△24.2P	△2.9%	△19.2P

* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

27/32

受注残高の推移予測



平面研磨事業

28/32

自社株買い実施および配当計画について

1. 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

取得対象株式の種類 : 当社普通株式
取得しうる株式の総額 : 1,800,000株(上限)
株式の取得価額の総額 : 1,000百万円(上限)
取得方法 : 市場取引
取得期間 : 平成20年11月11日～平成21年1月23日

2. 配当計画について

1株当たり配当金

中間期末時点 30円(うち、設立50周年記念配当10円)
期末時点 20円
合計 50円

今期の方針・取組み

方針

強固な財務基盤を武器に、厳しい経営環境においても、成長路線を確たるものにする。

取組み

1. 製品開発の強化
2. 消耗品販売の拡大
3. 海外拠点での生産アイテムの拡充

<連結>



OBARAグループのVISION

ニッチ市場において

世界一の企業集団を目指す



31/32

ご静聴ありがとうございました



<http://www.obara.co.jp>